

# Arnitel® EM550

性能

TPC  
53肖氏D, 挤出级

性能	典型资料	单位	测试方法
<b>流变性能</b>			
熔体体积流动速度	<b>8</b>	cm <sup>3</sup> /10min	ISO 1133
温度	<b>230</b>	°C	ISO 1133
负荷	<b>2.16</b>	kg	ISO 1133
<b>机械性能</b>			
肖氏硬度D (3s)	<b>53</b>	-	ISO 868
拉伸模量	<b>200</b>	MPa	ISO 527-1/-2
应力@5%应变	<b>8.8</b>	MPa	ISO 527-1/-2
10%应变时的应力	<b>11.8</b>	MPa	ISO 527-1/-2
应力@50%应变	<b>13.8</b>	MPa	ISO 527-1/-2
简支梁缺口冲击强度(+23 °C)	<b>N</b>	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eA
简支梁缺口冲击强度(-30 °C)	<b>25</b>	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eA
<b>热性能</b>			
熔融温度(10 °C/min)	<b>207</b>	°C	ISO 11357-1/-3
维卡软化温度(50 °C/h 50N)	<b>90</b>	°C	ISO 306
Vicat软化温度 (50 °C/h 10N)	<b>190</b>	°C	ISO 306
线膨胀系数(平行)	<b>1.5</b>	E-4/°C	ISO 11359-1/-2
线膨胀系数(垂直)	<b>1.5</b>	E-4/°C	ISO 11359-1/-2
燃烧性 (1.5mm名义厚度)	<b>HB</b>	class	IEC 60695-11-10
测试用试样的厚度	<b>1.6</b>	mm	IEC 60695-11-10
<b>电性能</b>			
相对介电常数(100Hz)	<b>4.4</b>	-	IEC 60250
相对介电常数(1MHz)	<b>4</b>	-	IEC 60250
介质损耗因子(1MHz)	<b>400</b>	E-4	IEC 60250
体积电阻率	<b>1E11</b>	Ohm*m	IEC 60093
表面电阻率	<b>&gt;1E15</b>	Ohm	IEC 60093
介电强度	<b>21</b>	kV/mm	IEC 60243-1
相对漏电起痕指数	<b>600</b>	-	IEC 60112
<b>其它性能</b>			
密度	<b>1210</b>	kg/m <sup>3</sup>	ISO 1183
吸水性	<b>0.65</b>	%	Sim. to ISO 62
吸湿性	<b>0.2</b>	%	Sim. to ISO 62

16.07.2007

声明：DSM所提供的所有有关产品的资料，无论数据、建议或其他信息，都是经过研究的，值得信赖的。但是DSM对上述信息，诸如：牌号、适用范围、特定用途、处理或任何由此在加工、处理等实务中引发的不确定因素和后果不承担责任。文档使用者在实务中应确保数据的可靠性，质量检验和其他性能以及由此而引起的后果承担全部责任。